

하이닉스, 미국 오리건공장 가동중단

200mm 웨이퍼 생산 HSMA 공정 멈춰... 비효율적 생산시설 구조조정

하이닉스반도체는 7월24일 생산설비 합리화를 위해 200mm 웨이퍼를 생산하는 미국 오리건 유진(Eugene)의 미국 생산법인 HSMA(Hynix Semiconductor Manufacturing America)의 가동을 중단하기로 했다고 발표했다.

이에 따라 유진 공장은 즉시 웨이퍼 투입을 중단하며 9월 말까지 모든 공정활동을 멈추게 된다.

하이닉스는 D램 등 메모리 산업에서 200mm 웨이퍼 생산설비로는 더 이상 경쟁력을 유지하기 어려운 현실에 따라 200mm 생산비중을 대폭 낮추고 300mm로의 이행을 가속화하기 위해 가동중단을 결정했다고 밝혔다.

하이닉스는 “호황기보다는 불황기가 상대적으로 비효율적인 생산시설을 구조조정하는 데 적기”라며 “비용 축소와 유동성 확보를 위해서도 적자 발생의 주요 원인이 되는 200mm 생산설비의 단계적 정리와 300mm 생산설비로의 빠른 이행은 모든 메모리 생산기업의 주요한 과제 중 하나”라고 말했다.

하이닉스는 200mm 웨이퍼 생산비중을 2007년 약 50% 수준에서 2008년 약 35% 수준까지 감축할 계획에 따라 2007년 9월 중국 Wuxi 공장의 200mm 생산시설인 C1 팹의 장비를 CRH(China Resource Holdings)에 매각한 데 이어 미국 공장의 정리 절차에 들어간 것이다.

유진 공장에서 생산되던 제품은 생산효율이 상대적으로 우수한 국내 200mm공장에서 생산 공급하게 된다.

하이닉스는 “유진 공장의 가동중단을 통해 만성 적자 품목의 생산과 공급을 크게 줄임으로써 연간 상당 규모의 영업적자 요인을 제거하게 됐고, 재고에 따른 현금부담도 완화해 사업기반과 이익구조를 건전화할 수 있게 됐다”며 “가동 중단 후 유진공장 처리를 놓고 다른 반도체 생산기업에 매각하거나 건물과 토지, 장비를 분리해 매각하는 등의 다각적인 방안을 검토하고 있다”고 밝혔다.

앞서 하이닉스는 경쟁력이 한계에 이른 200mm 팹의 활용 방안의 일환으로 중국 Wuxi C1 팹의 장비를 매각했고, 경기 이천의 M7, 청주의 M8, M9 팹은 일부는 컨슈머 D램 및 비메모리 제품 생산, 파운드리 서비스 등에 활동하고 있으며 남은 장비는 매각을 진행하고 있다. <저작권자 연합뉴스 - 무단전재·재배포 금지>

<화학저널 2008/07/25>